

台灣智慧技術協會 函

地址：100台北市忠孝西路一段50號18樓之11

承辦人：AI問卷調查

Email：sec@tsta-tw.org.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國113年8月16日

發文字號：台協紀字第2024081601號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：邀請參與本會「AI人工智慧大語言模型研析與微調實戰」，以及填寫 AIGC產學合作平台問卷調查。

說明：

- 一、本會在2022年、2023年推動下，已經成功促成12家學研單位與法人及企業進行AI技術合作。並從北極雲海GPU雲獲取了超過50萬小時的GPU算力於AIGC圖像生成、LLM模型訓練等合作上。由於AI落地的需求更為強烈，因此我們將擴大將企業、以及AI人力媒合納入。
- 二、歡迎有意願進行產學合作、跨單位技術合作之學研究人員、研究成果推廣單位(如研發處、育成中心)、應屆畢業生協助填寫 TSTA AIGC產學合作平台問卷調查。

<https://forms.gle/oi3k9nTMTwQt7Qry5>

- 三、詳細資訊 https://tsta-tw.org.tw/?page_id=861

- 四、本會同時與台灣網路工程師社群於2024/8/20於台大醫院國際會議中心舉辦LLM大語言模型工作坊，本會特別提供12位學研界免費名額，報名網址：<https://twnog.kktix.cc/events/twnog5-workshop-aprigrf>，選擇 台灣學研界

國立嘉義大學



社群票，輸入邀請碼TSTALLM 即可免費參與。名額有限，
歡迎對LLM有興趣的學研究報名參加交流。

正本：全國大專院校

副本： 電子公文
2024/08/19 09:59:58
交換章

裝

訂

線

